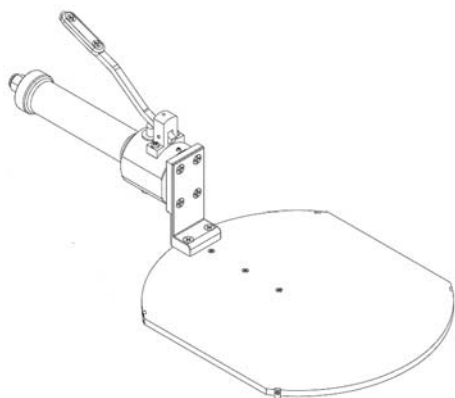




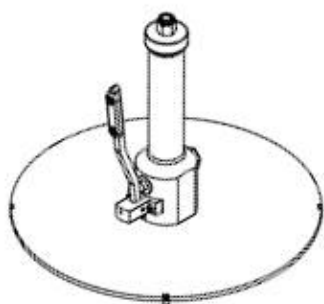
Breeze™非接触型ハンドリングツール

脆弱な極薄ウエハに最適な非接触式のウエハハンドリングツールです。化合物半導体材料（GaAs、GaN、InP、SiC）など衝撃と熱のいずれにも非常に傷つきやすい基板や真空ピンセットでは保持が不可能な表面に多数の穴・凹凸・反りのあるウエハ或いは厚ウエハなど様々なサイズや形状のウエハに対応します。

圧縮ガス（CDA或いは窒素）を利用して、中央のスパージャ管からウエハの外周へ気流を送ります。ベルヌーイの定理の差圧により、Breeze™ワンドのプレート表面から約200μm（0.2mm）ウエハを“浮上”させます。保持されたウエハが水平方向に位置ずれしないよう囲いピンが付いています。



H2BST-4	100mm	水平式
H2BST-6	150mm	水平式
H2BST-8	200mm	水平式
H2BST-12	300mm	水平式

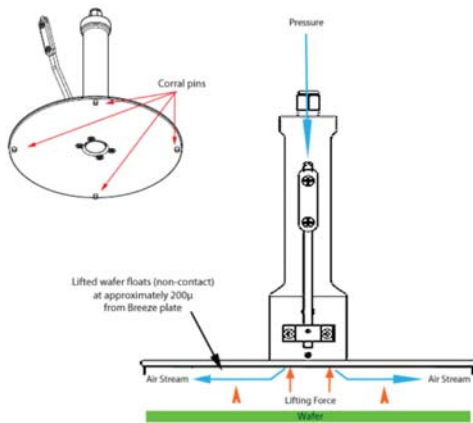
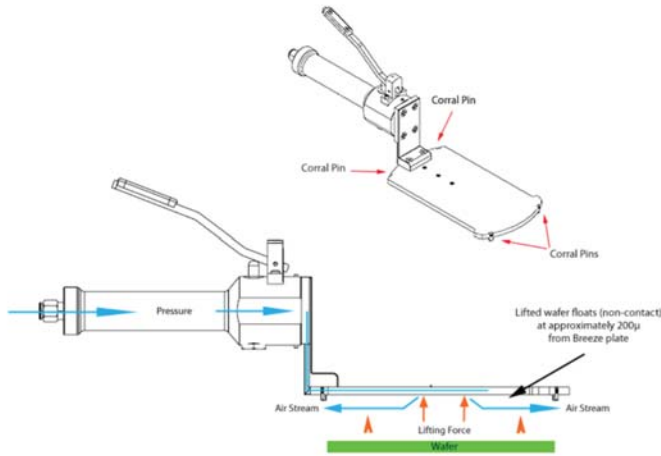


H2B-4	100mm	垂直式
H2B-6	150mm	垂直式
H2B-8	200mm	垂直式
H2B-12	300mm	垂直式

Bernoulli Handling

B R E E Z E ™

非接触型ハンドリングツール



材質

ハンドル : 静電気対策アセタール
 表面抵抗値 : $10^{10} - 10^{12} \Omega/\text{sq}$
 プレート : 透明ESDポリカーボネート
 囲いピン : 静電気対策アセタール
 トリガー/レバー : 316SS

外部接続チューブ : OD6.4mm(±0.25mm)

必要な環境 : CDA または N2

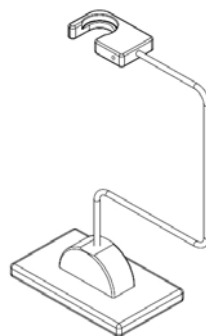
圧力 : 69K~410Kpa / 流量28~57ℓ/min

重量 : 0.28Kg

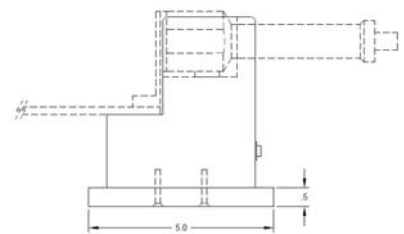
専用ホルダー

HBH-001 H2B 型用

H-H2BST H2BST型用



HBH-001



H-H2BST